证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-025

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于＜公司2025第一季度报告＞的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

2024年度公司总经理骈文胜先生按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

2024年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于＜公司2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于＜公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

公司独立董事向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上分别进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性评估的议案》

公司独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事林秀强、王怀芳、宋海燕回避表决。

8、审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的资产负债状况，以及2024年全年度的经营成果和现金流量。董事会同意公司2024年度财务决算报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于＜2024年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于董事2025年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司董事2025年度薪酬方案并同意提交董事会，公司董事2025年度薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体职务的其他董事，不在公司领取薪酬，不给予津贴。

独立董事的薪酬标准确定为：8万元人民币/年(税前)。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过，全体委员均回避表决。

本议案全体董事回避表决，同意直接提交股东大会审议。

15、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司高级管理人员2025年度薪酬方案并同意提交董事会审议，公司高级管理人员薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事骈文胜、闻国涛、王沛、路峰回避表决。

16、审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-027

上海伟测半导体科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”)2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。本说明中若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1878号)，本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,180.27万股，发行价为每股人民币61.49元，共计募集资金1,340,648,023.00元，坐扣承销和保荐费用78,162,309.27元后的募集资金为1,262,485,713.73元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,306,164.68元后，公司本次募集资金净额为1,237,179,549.05元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-69号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	123,717.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	124,314.89
	利息收入净额	B2	1,313.46
本期发生额	项目投入	C1	594.50
	利息收入净额	C2	0.79
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	124,909.39
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,314.25
应结余募集资金		E=A-D1+D2	122.81
实际结余募集资金		F	-
差异[注]		G=E-F	122.81

[注]差异一部分系公司使用自有资金支付30.95万元印花税所致，另一部分系无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目和集成电路测试研发中心建设项目全部投资款项支付完成之日时的节余募集资金以及后续产生的利息共计153.76万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少122.81万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

公司、项目所属子公司、原保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”)已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2023年1月21日、2023年3月23日、2023年7月19日和2023年12月2日分别披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，相应的募集资金监管协议已终止。2024年7月9日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。公司因聘请平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接方正承销保荐尚未完成的持续督导工作。公司、项目所属子公司、保荐机构平安证券已分别与存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金四方监管协议》。具体详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金四方监管协议的公告》，前述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金已按规定全部使用完毕，全部募集资金专户均已注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。

2、补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

3、“超募资金——伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”尚未达到预定可使用状态，暂时无法测算效益。

4、“超募资金——伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”2024年12月达到预定可使用状态，但截至2024年12月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(七)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2024年度，公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(九)节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况

(十)募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2024年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：伟测科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了伟测科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：伟测科技2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对伟测科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额					123,717.95					本年度投入募集资金总额					594.50		
变更用途的募集资金总额										已累计投入募集资金总额					124,909.39		
变更用途的募集资金总额比例																	
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化					
无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	否	48,828.82	48,828.82	48,828.82	0	48,797.15	-31.67	99.94	2023年7月	16,427.31[注2]	否[注2]	否					
集成电路测试研发中心建设项目	否	7,366.92	7,366.92	7,366.92	0	7,408.42	41.50	100.56[注1]	2023年8月	不适用	不适用	否					
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	5,019.70	19.70	100.39[注1]	不适用	不适用	不适用	否					
承诺投资项目小计	—	61,195.74	61,195.74	61,195.74	0	61,225.27	29.53	—	—	—	—	—					
超募资金项目																	
超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	否	15,000.00	25,000.00[注3]	25,000.00	481.52	25,218.69	218.69	100.87[注1]	2027年10月	不适用	不适用	否					
超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	否	15,000.00	38,347.49[注4]	38,347.49	112.98	38,465.43	117.94	100.31[注1]	2024年12月	不适用	不适用	否					
超募资金项目小计		30,000.00	63,347.49	63,347.49	594.50	63,684.12	336.63	—	—	—	—	—					
合 计	—	91,195.74	124,543.23	124,543.23	594.50	124,909.39	366.16	—	—	—	—	—					
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用												
募集资金结余的金额及形成的原因					不适用												
募集资金其他使用情况					不适用												

[注1]集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目、伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入。

[注2] 无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目本年实现的效益16,427.31万元为2024年实现的收入。该项目未达到预计收益的原因主要为2023年全球终端市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，2024年尚处于复苏阶段，产能利用率水平未达到预期。

[注3]公司于2023年6月30日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金25,000.00万元实施该项目。

[注4] 公司于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。公司于2023年10月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用剩余超募资金133,474,873.89元及孳息向全资子公司南京伟测提供借款以继续实施募投项目，独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金38,347.49万元实施该项目。

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-030

上海伟测半导体科技股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“伟测科技”或“公司”)于2025年4月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,426.03万元(含税)置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金180.07万元(不含税)置换已预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕158号)同意，公司向不特定对象发行117,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,175,000手(11,750,000张)。本次发行的募集资金总额为人民币117,500.00万元，扣除不含税的发行费用12,016,745.28元，实际募集资金净额为1,162,983,254.72元。上述募集资金已于2025年4月15日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月15日出具了《验资报告》(天健验[2025]6-4号)。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构平安证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，按露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	名称	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	70,000.00
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	20,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	27,500.00	27,500.00
合计		216,240.00	117,500.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会(或董事会授权人士)可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

(一)以自筹资金预先投入募投项目和置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2025年4月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币77,426.03万元(含税)，公司将对上述预先投入的自筹资金进行置换。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	名称	投资总额	本次募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	70,000.00	58,938.02	58,938.02
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	20,000.00	18,488.01	18,488.01
3	偿还银行贷款及补充流动资金	27,500.00	27,500.00	-	-
合计		216,240.00	117,500.00	77,426.03	77,426.03

注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

(二)以自筹资金预先支付发行费用和置换情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金各项发行费用合计人民币1,201.67万元(不含税)，截至2025年4月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币180.07万元(不含税)，本次拟置换金额为人民币180.07万元(不含税)。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	费用总额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
发行费用	1,201.67	180.07	180.07

综上，公司本次合计拟使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金为人民币77,606.10万元，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

上述事项已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2025]6-486号)。

四、相关审议程序

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,426.03万元(含税)置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金180.07万元(不含税)置换已预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司相关制度的规定。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合全体股东利益，相关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金77,426.03万元(含税)置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金180.07万元(不含税)置换已预先支付发行费用的自筹资金。

(二)会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：伟测科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了伟测科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：伟测科技使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述相关事项出具了鉴证报告，履行了必要的程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，本次使用募集资金置换事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐机构对伟测科技使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

公司代码：688372　　公司简称：伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本113,834,777股，以此计算合计拟派发现金红利人民币38,703,824.18元(含税)，合计拟转增股本34,150,433股。现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%。

如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

上述预案尚需公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	伟测科技	688372	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王沛	刘丹
联系地址	上海市浦东新区东胜路38号D区1栋	
电话	021-58958216	
传真	无	
电子信箱	ir@v-test.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

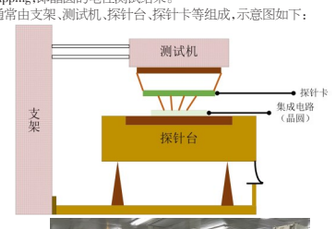
2.1 主要业务、主要产品或服务情况

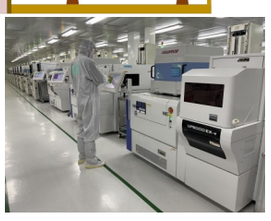
公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开发、SLT测试、老化测试等全流程测试服务，测试的晶圆和成品芯片在类型涵盖CPU、GPU、MCU、FPGA、SoC芯片、AI芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类，在工艺上涵盖各类制程，在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品，在下游应用上包括通讯、计算机、汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

1、晶圆测试

晶圆测试(Chip Probing)，简称CP，是指通过探针台和测试机的配合使用，对晶圆上的裸芯片进行功能和电参数测试，其测试过程为：探针台将晶圆逐片自动传送至测试位置，芯片的端点通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给探针台，探针台据此对芯片进行打点标记，形成晶圆的Mapping，即晶圆的电性测试结果。

晶圆测试系统通常由支架、测试机、探针台、探针卡等组成，示意图如下：

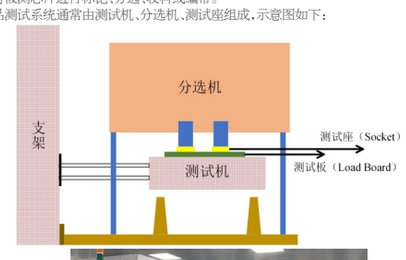


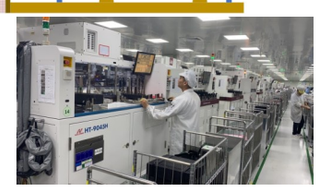


2、芯片成品测试

芯片成品测试(Final Test)，简称FT，是指通过分选机和测试机的配合使用，对封装完成后的芯片进行功能和电参数测试，其测试过程为：分选机将被测芯片逐个自动传送至测试工位，被测芯片的引脚通过测试工位上的基座、专用连接线与测试机的功能模块进行连接，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给分选机，分选机据此对被测芯片进行标记、分选、收料或编带。

芯片成品测试系统通常由测试机、分选机、测试座组成，示意图如下：





3、其他服务

为了更好地服务客户、增强客户粘性，公司还会向客户提供测试设备租赁、测试辅材的销售等服务。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司通过自主研发的集成电路测试技术、先进的集成电路测试设备以及高效快捷的测试生产和技术服务体系，向芯片设计企业、晶圆制造企业、封装企业和IDM企业提供晶圆测试、芯片成品测试服务，从而获取收入、赚取利润。

2、生产模式

公司根据客户订单及自身产能情况安排测试服务，并对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的生产问题，保证测试作业的顺利完成。公司的生产工作主要由制造部下属的各测试工厂来承担，其他部门配合完成。实际运行中，公司生产部门在接收客户来料后，相关部门完成客户信息建档和来料检验、销售客服部投单排产，生产部门依照工单组织测试作业。

3、销售模式

公司测试服务采用直销的销售模式，主要的客户群体为集成电路设计、制造、封装和IDM企业，客户分布区域以长三角地区为主，向南延伸至珠三角地区，向北延伸至东北地区。

在销售的组织架构方面，公司的销售工作由销售客服部承担，销售客服部设置市场销售和客服计划两大职能岗位。市场销售人员主要负责营销方案的制订、新客户的接洽及引进，客服计划人员主要负责投标排产、客户关系维护以及回款管理等。

在客户开拓方面，公司目前已建立起一支专业能力强、行业经验丰富的销售团队，主动开发各类新客户。同时，基于公司服务品质的良好口碑，老客户引荐也是公司十分重要的获客方式。

在销售定价方面，公司销售人员经前期洽谈确定客户需求后，与客户商量确定测试服务价格，由于各家客户的晶圆及芯片都是不同的，因此测试服务价格以测试平台的配置和所需的工时为基础进行定价。

在合同签订及结算方式方面，公司成功进入客户的供应商体系后，双方签订框架性协议，开展长期合作。公司针对不同